2026年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年11月16日

上場会社名　　ウインテスト株式会社　　上場取引所　東
コード番号　　6721　　ＵＲＬ　https://www.wintest.co.jp/
代表者　　（役職名）代表取締役　　（氏名）姜　輝
問合せ先責任者　（役職名）管理本部長　　（氏名）鎌田 文明　　ＴＥＬ　045-317-7888

配当支払開始予定日　　－
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無　　：無

（百万円未満切捨て）

１．2026年12月期第３四半期の連結業績（2026年１月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年12月期第３四半期	238	△11.6	△591	－	△585	－	△612	－
2025年12月期第３四半期	270	△25.4	△623	－	△621	－	△644	－

（注）包括利益　2026年12月期第３四半期　△559百万円（－%）　2025年12月期第３四半期　△665百万円（－%）

	１株当たり四半期純利益	潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年12月期第３四半期	△10.81	－
2025年12月期第３四半期	△12.21	－

（注）2026年12月期第３四半期及び2025年12月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年12月期第３四半期	592	272	45.6
2025年12月期	919	343	37.4

（参考）自己資本　2026年12月期第３四半期　269百万円　2025年12月期　343百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年12月期	－	0.00	－	0.00	0.00
2026年12月期	－	0.00	－		
2026年12月期（予想）				0.00	0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2026年12月期の連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,662	287.4	56	－	52	－	52	－	0.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

業績予想に関しましては、現時点では業績予想を合理的に見直すための判断材料が十分ではないことから、業績予想は据え置いており、見通しが明らかになり次第、速やかに開示いたします。

※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更	：無
②　①以外の会計方針の変更	：無
③　会計上の見積りの変更	：無
④　修正再表示	：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年12月期３Ｑ	59,278,100株	2025年12月期	53,641,000株
②　期末自己株式数	2026年12月期３Ｑ	－株	2025年12月期	－株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2026年12月期３Ｑ	56,690,225株	2025年12月期３Ｑ	52,765,850株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料２ページ「１．経営成績等の概況（１）当四半期の経営成績の概況」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当四半期の経営成績の概況…… 2
（２）当四半期の財政状態の概況…… 3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 3
（４）継続企業の前提に関する重要事象等 …… 4
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …… 6
（１）四半期連結貸借対照表 …… 6
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 8
四半期連結損益計算書 …… 8
四半期連結包括利益計算書 …… 9
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 10
（継続企業の前提に関する注記） …… 10
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 14
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） …… 14
（セグメント情報等の注記） …… 14
（重要な後発事象の注記） …… 15

１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第３四半期連結累計期間（2026年１月１日～2026年９月30日）における世界半導体市場は、生成AIの普及拡大やAIデータセンター向けの設備投資を背景に、先端ロジック半導体及び高帯域メモリ（HBM）を中心として高い成長が続いております。

SEMI（国際半導体製造装置材料協会）が2026年７月に公表した予測によれば、2026年の世界半導体製造装置市場は前年比23.2%増の1,659億米ドルとなり、過去最高を更新する見通しです。また、半導体テスト装置市場についても、AI関連半導体の高性能化や検査工程の高度化を背景に、前年比31.0%増の153億米ドルに達すると予測されております。

一方、こうした半導体市場全体の成長は、主としてAI関連の先端ロジック及びメモリ分野への投資拡大に牽引されたものであり、当社グループが主力とするディスプレイ・ドライバーIC（DDIC）、汎用ロジックIC等の民生・産業向け半導体分野においては、需要回復の動きが依然として限定的な状況にあります。特に、当社グループの主要市場である中国及び台湾においては、顧客の設備投資判断が慎重に推移しており、既存検査装置の稼働率改善が必ずしも新規設備投資に結び付かない状況が続いております。このため、当社グループの主力検査装置に対する新規受注及び売上計上は当初想定を下回り、当第３四半期連結累計期間における業績は厳しい状況で推移いたしました。

当社グループでは、こうした市場環境に対応するため、次世代高精度高速検査システム「WTS-577SX」「WTS-577SR」及び多チャンネル対応の「WTS-9000」等を中心に、既存顧客への提案活動強化、装置評価及び新規顧客の開拓を継続しております。また、顧客ニーズに対応した検査機能の高度化や製品ラインアップの拡充を進め、今後の市場回復局面における受注機会の獲得に向けた営業・技術体制の強化に取り組んでおります。

また、上述のような厳しい状況を打破するため、当社グループは、特定の半導体市場に業績が左右されやすい事業構造からの転換を重要な経営課題と位置付け、既存の半導体後工程検査装置事業に加え、半導体前工程検査装置分野及び新たな産業領域への事業展開を進めております。半導体前工程検査装置事業につきましては、2025年12月26日に新規参入を公表(＊１)して以降、大阪事業所におけるクリーンルーム環境の整備、製造技術者の育成、装置の組立・調整技術の習得及び国内外における顧客開拓を進めております。2026年７月から８月にかけては、当社製の前工程検査装置をシンガポールの顧客協力企業へ納入し、実際の半導体製造環境を想定した装置評価を開始いたしました。さらに、2026年10月15日には、海外大手半導体関連企業との間で秘密保持契約（NDA）を締結し、日本国内に建設が予定されている半導体製造工場への装置導入に向け、対象検査工程、要求仕様及び装置構成等に関する具体的な協議を開始したことを当社Webサイトにて公表(＊２）しております。なお、本件NDAは現時点において受注を意味するものではありませんが、当社が進める半導体前工程検査装置事業の事業化に向けた取り組みの一つと位置付けております。

また、新たな検査装置分野として、AIデータセンター向け半導体周辺領域で採用が飛躍的に拡大している、シリコンキャパシター（SiCap）向け検査装置事業への展開を進めております。既存の半導体検査技術を応用し、新たなデバイス市場への対応を図ることで、半導体関連事業における取扱製品及び顧客基盤の拡充を目指しております。

これらの取り組みを通じて、従来の民生・産業向け半導体検査装置市場に加え、先端半導体製造工程やAI関連半導体分野における事業機会の獲得を目指し、2027年以降の事業基盤の拡大に向けた準備を進めております。

半導体関連事業以外におきましても、IoTヘルスケア装置「Body Beat」、自重補償機構（MGC技術）を応用した荷役装置、アルカリイオン洗浄水生成装置及び液体レンズ「RYUGU」等の新規事業について、製品機能の改良、品質・性能評価、販売体制の整備及び顧客開拓を継続しております。これらの新規事業は、製品ごとに事業化の進捗段階が異なり、現時点における連結業績への寄与は限定的でありますが、既存の技術資産や製造・販売基盤を活用しながら、将来の収益機会の拡大に向けた取り組みを進めております。当社グループといたしましては、引き続き厳しい事業環境に対応するため、経営資源の効率的な配分と費用管理の徹底を図るとともに、既存事業の収益力回復及び新規事業の事業化を両輪として、中長期的な収益基盤の強化に取り組んでまいります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は238,970千円（前年同四半期比11.6%減）、営業損失591,122千円（前年同四半期は営業損失623,400千円）、経常損失585,955千円（前年同四半期は経常損失621,150千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失612,997千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失644,425千円）となりました。

なお、2026年11月４日公表(＊３)のとおり、当社の親会社でありました武漢精測電子集団股份有限公司は、第12回新株予約権の行使により、議決権に対する割合が減少したため、2025年２月３日をもってその他の関係会社となっております。

＊１　2025年12月25日公表　「新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関するお知らせ」
＊２　2026年10月15日当社Webサイト公表　「半導体前工程検査装置事業の進捗に関するお知らせ」
＊３　2026年11月４日公表　「親会社の異動等に関するお知らせ（開示遅延）」

（２）当四半期の財政状態の概況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ334,264千円減少し、557,612千円（前連結会計年度末比37.5％減）となりました。この主な要因は、売掛金が186,474千円減少したこと、また、棚卸資産評価損を計上したことにより、商品及び製品が48,364千円減少、原材料及び貯蔵品が114,942千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ7,007千円増加し、34,493千円（前連結会計年度末比25.5％増）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が2,125千円減少したものの、投資有価証券が3,000千円増加し、また、リース資産が6,132千円増加したことによるものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ244,886千円減少し、236,598千円（前連結会計年度末比50.9％減）となりました。この主な要因は、買掛金が163,269千円減少し、短期借入金が80,000千円減少、また、１年以内返済予定の長期借入金が8,390千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ11,391千円減少し、82,985千円（前連結会計年度末比12.1％減）となりました。この主な要因は、長期リース債務が4,609千円増加したものの、長期借入金が16,075千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ70,978千円減少し、272,521千円（前連結会計年度末比20.7％減）となりました。この主な要因は、為替換算調整勘定が53,820千円増加し、資本金と資本準備金がそれぞれ242,700千円増加したものの、利益剰余金が612,997千円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の世界半導体市場につきましては、生成AIの普及拡大やデータセンターへの設備投資を背景として、先端ロジック半導体及び高帯域メモリ（HBM）を中心に成長が継続するものと見込まれております。SEMIが2026年７月に公表した予測によれば、世界半導体製造装置市場は2027年以降も拡大が続く見通しとなっております。一方、当社グループが主力とするディスプレイ・ドライバーIC（DDIC）、汎用ロジックIC等の民生・産業向け半導体分野では、依然として顧客の新規設備投資に慎重な姿勢が見られ、AI関連市場の成長が当社の主力事業に直接波及するまでには、なお一定の時間を要するものと認識しております。

こうした市場環境を踏まえ、当社グループでは、既存の半導体検査装置事業における受注回復に向けた取り組みを継続するとともに、半導体前工程検査装置分野及びAI関連市場への事業領域の拡大を推進し、特定の市場動向に左右されにくい収益構造への転換を進めてまいります。

既存の半導体検査装置事業につきましては、次世代高精度高速検査システム「WTS-577SX」「WTS-577SR」そして、開発に特化した「WTS-588D」の量産版として「WTS-588」の開発を進めております。ハイエンド向けとしては、多チャンネル対応の「WTS-9000」を主軸とすることで、中国、台湾及び国内市場における営業活動を継続してまいります。また、顧客の検査ニーズの高度化に対応するため、高速・高電圧ロジック検査機能をはじめとする次世代オプションの開発及び製品機能の拡充を進め、既存顧客との関係強化と新規顧客の開拓を図ってまいります。

中国の当社100％出資製造子会社である偉恩測試技術（武漢）有限公司につきましては、開発、製造品質及び顧客サポート体制の向上に加え、日本国内の開発・営業部門との連携を強化し、中国市場における顧客対応力及び受注競争力の向上を図ってまいります。

新たな事業領域として取り組んでおります半導体前工程検査装置事業につきましては、本年６月に完了した大阪事業所のクリーンルームに加え、追加工事を行い、新領域に既存クリーンルームを活用できるようにし、製造・評価体制の整備を進めるとともに、2027年には今後の事業規模拡大を見据えた設備の更なる追加拡張を進めてまいります。また、シンガポールの顧客協力企業における実機評価や製造技術者の育成を継続し、2027年３月からの本格的な事業展開に向けて準備を進めてまいります。

さらに、2026年10月15日に当社Webサイトにて公表(＊１)いたしましたとおり、海外大手半導体関連企業との間で秘密保持契約（NDA）を締結し、日本国内に建設が予定されている大規模半導体製造工場への装置導入に向けた具体的な案件協議を開始しております。本件は現時点において受注を意味するものではありませんが、顧客要求に基づく装置仕様の検討及び技術的な協議を進めることで、将来の事業化につなげてまいります。

また、半導体関連の新製品として、シリコンキャパシター（SiCap）向けウエハ検査装置「WTS-513SC」の開発を完了し、2026年12月からの販売開始を予定しております。本装置は、シリコンウエハ上に形成されたキャパシターの電気特性を検査するものであり、当社が培ってきた高精度測定及び多チャンネル並列検査技術を活用しております。今後、AI・高性能コンピューティング（HPC）及び先端半導体パッケージ分野等で需要の拡大が期待される高性能電子部品の検査市場に向け、国内外で営業活動を進めてまいります。

これらの取り組みにより、当社グループは、従来の民生・産業向け半導体検査装置市場に加え、先端半導体製造工程及びAI関連分野への事業領域の拡大を図り、半導体検査装置事業全体の収益機会の拡充を目指してまいります。今後とも、半導体検査装置事業以外の新規事業につきましても、これまで培ってきた技術開発力、製造技

術及び販売ネットワークを活用し、事業の多角化を進めております。

IoTヘルスケア装置「Body Beat」につきましては、現行製品の精度向上を目指し、生体情報の測定・解析機能及びアプリケーションの改良を継続するとともに、製品品質の向上及び販売体制の整備を進めております。また、自重補償機構（MGC技術）を応用した荷役装置については、製品の実用化及び事業化に向けた取り組みをご協力頂ける架装業者様とともに継続しております。アルカリイオン洗浄水生成装置につきましては、生成能力及び洗浄性能の向上に向けた開発成果を活用し、洗浄槽及び自動化企業様と協業し、洗浄装置一体型製品として協力体制、製造・販売体制の整備を進めております。また、液体レンズ「RYUGU」については、大学・研究機関向けの販売に加え、製造工場ラインにおける出荷品質検査に採用を頂く事ができました。今後、更に製品検査産業用機器メーカ様とのコラボ、より広い領域における応用及び顧客用途の拡大を図ってまいります。さらに、産業用自律走行搬送ロボット（AMR）販売事業につきましても、既存の半導体・電子部品製造分野における顧客ネットワークを活用し、工場内物流の自動化及び省人化に対する需要を取り込むべく、営業活動を進めてまいります。

これらの新規事業につきましては、事業化の進捗及び収益化の時期がそれぞれ異なることから、引き続き市場性、収益性及び投資効率を検証しながら、新たな資金調達なども視野に入れ、経営資源の効率的な配分を図ってまいります。

当社グループの2026年12月期の業績につきましては、主力とする民生・産業向け半導体検査装置市場の回復が当初想定を下回っていることから、引き続き厳しい事業環境が見込まれております。2026年12月期の業績予想に関しましては、現時点では業績予想を合理的に見直すための判断材料が十分ではないことから、業績予想は据え置いており、見通しが明らかになり次第、速やかに開示いたします。

一方、半導体前工程検査装置事業及び新たな検査装置分野への参入など、将来の収益基盤の拡大に向けた取り組みは進展しております。今後は、既存事業における受注獲得及び収益力の回復を最優先課題としつつ、新規事業の早期収益化、製造・販売体制の強化並びに経営資源の最適配分を進め、業績回復と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

＊１　2026年10月15日当社Webサイトにて公表　「半導体前工程検査装置事業の進捗に関するお知らせ」

（４）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において、AI関連以外半導体への設備投資が活発でなかったことから、売上・受注時期がずれ込み、売上高は429,053千円となりました。また、棚卸資産の評価を厳格に行った結果、営業損失は1,218,662千円、経常損失は1,217,996千円、親会社株主に帰属する当期純損失は1,242,428千円となりました。

当第３四半期連結累計期間（2026年１月１日～2026年９月30日）における世界半導体市場は、生成AIの普及拡大やAIデータセンター向けの設備投資を背景に、先端ロジック半導体及び高帯域メモリ（HBM）を中心として高い成長が続いております。SEMIが2026年７月に公表した予測によれば、2026年の世界半導体製造装置市場は前年比23.2%増の1,659億米ドルに達する見通しとなっております。

一方、こうした半導体市場全体の成長は、主としてAI関連の先端ロジック及びメモリ分野への設備投資拡大に牽引されたものであり、当社グループが主力とするディスプレイ・ドライバーIC（DDIC）や汎用ロジックIC等の民生・産業向け半導体分野においては、需要回復の動きが依然として限定的な状況にあります。特に、当社グループの主要市場である中国及び台湾においては、顧客による新規設備投資の判断が慎重に推移しており、既存設備の稼働状況に改善の兆しが見られる一方、新たな検査装置への投資は限定的な状況が続いております。このため、当社グループの主力検査装置に対する受注及び売上計上は当初想定を下回り、厳しい事業環境が継続しております。

このような事業環境に対応するため、当社グループでは、既存の半導体検査装置事業における営業活動及び製品競争力の強化を進めるとともに、半導体前工程検査装置事業やシリコンキャパシター（SiCap）向け検査装置事業など、新たな事業領域への展開を進めております。また、既存の製造設備や技術資産の有効活用を図りながら、事業領域の拡大と収益構造の改善に向けた取り組みを進めております。こうした状況を踏まえ、当社グループでは、既存の半導体検査装置事業における営業活動の強化、製品競争力の向上及び製造体制の効率化を進めるとともに、従来の後工程検査装置分野に加え、半導体前工程検査装置分野への事業領域の拡大を進めております。

しかしながら、これらの取り組みは本格的な収益貢献に至るまでに一定の期間を要することから、当第３四半期連結累計期間においては、既存事業の受注低迷を補うには至っておりません。

以上より、当第３四半期連結累計期間の売上高は238,970千円にとどまり、営業損失591,122千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を612,997千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	82,957	35,490
売掛金	212,063	25,588
電子記録債権	1,336	－
商品及び製品	57,461	9,096
仕掛品	293,774	336,273
原材料及び貯蔵品	193,935	78,992
前渡金	2,987	37,378
未収消費税等	25,054	19,737
その他	22,306	15,054
流動資産合計	891,876	557,612
固定資産		
有形固定資産		
建物	16,777	16,777
減価償却累計額	△16,777	△16,777
建物（純額）	－	－
車両運搬具	8,885	－
減価償却累計額	△8,885	－
車両運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品（純額）	－	－
リース資産	－	6,389
減価償却累計額	－	△257
リース資産（純額）	－	6,132
有形固定資産合計	－	6,132
投資その他の資産		
投資有価証券	－	3,000
その他	27,486	25,361
投資その他の資産合計	27,486	28,361
固定資産合計	27,486	34,493
資産合計	919,363	592,105

（単位：千円）

	前連結会計年度 （2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
買掛金	221,208	57,939
短期借入金	100,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	32,064	23,674
未払金	79,462	79,540
未払法人税等	2,476	1,661
契約負債	3,289	19,313
その他	42,982	34,468
流動負債合計	481,484	236,598
固定負債		
長期借入金	72,838	56,763
リース債務	6,221	10,830
資産除去債務	15,318	15,391
固定負債合計	94,377	82,985
負債合計	575,862	319,583
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,029,658	2,272,358
資本剰余金	2,316,144	2,558,844
利益剰余金	△4,371,444	△4,984,442
株主資本合計	△25,641	△153,238
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	369,141	422,962
その他の包括利益累計額合計	369,141	422,962
新株予約権	－	2,798
純資産合計	343,500	272,521
負債純資産合計	919,363	592,105

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
売上高	270,308	238,970
売上原価	369,349	324,962
売上総損失（△）	△99,040	△85,991
販売費及び一般管理費	524,360	505,131
営業損失（△）	△623,400	△591,122
営業外収益		
受取利息	461	281
為替差益	－	6,193
補助金収入	2,337	－
スクラップ売却益	1,846	2,653
その他	626	573
営業外収益合計	5,272	9,701
営業外費用		
支払利息	2,507	3,992
支払手数料	490	516
その他	23	25
営業外費用合計	3,021	4,534
経常損失（△）	△621,150	△585,955
特別利益		
新株予約権戻入益	8,702	－
固定資産売却益	－	220
特別利益合計	8,702	220
特別損失		
減損損失	30,058	25,361
特別損失合計	30,058	25,361
税金等調整前四半期純損失（△）	△642,506	△611,096
法人税、住民税及び事業税	1,919	1,901
法人税等調整額	－	－
法人税等合計	1,919	1,901
四半期純損失（△）	△644,425	△612,997
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△644,425	△612,997

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
四半期純損失（△）	△644,425	△612,997
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△21,007	53,820
その他の包括利益合計	△21,007	53,820
四半期包括利益	△665,432	△559,177
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△665,432	△559,177
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、前連結会計年度において、AI関連以外半導体への設備投資が活発でなかったことから、売上・受注時期がずれ込み、売上高は429,053千円となりました。また、棚卸資産の評価を厳格に行った結果、営業損失は1,218,662千円、経常損失は1,217,996千円、親会社株主に帰属する当期純損失は1,242,428千円となりました。また、営業キャッシュ・フローは、751,167千円のマイナスとなりました。

当第３四半期連結累計期間（2026年１月１日～2026年９月30日）における世界半導体市場は、生成AIの普及拡大やAIデータセンター向けの設備投資を背景に、先端ロジック半導体及び高帯域メモリ（HBM）を中心として高い成長が続いております。SEMIが2026年７月に公表した予測によれば、2026年の世界半導体製造装置市場は前年比23.2%増の1,659億米ドルに達する見通しとなっております。

一方、こうした半導体市場全体の成長は、主としてAI関連の先端ロジック及びメモリ分野への設備投資拡大に牽引されたものであり、当社グループが主力とするディスプレイ・ドライバーIC（DDIC）や汎用ロジックIC等の民生・産業向け半導体分野においては、需要回復の動きが依然として限定的な状況にあります。特に、当社グループの主要市場である中国及び台湾においては、顧客による新規設備投資の判断が慎重に推移しており、既存設備の稼働状況に改善の兆しが見られる一方、新たな検査装置への投資は限定的な状況が続いております。このため、当社グループの主力検査装置に対する受注及び売上計上は当初想定を下回り、厳しい事業環境が継続しております。

このような事業環境に対応するため、当社グループでは、既存の半導体検査装置事業における営業活動及び製品競争力の強化を進めるとともに、半導体前工程検査装置事業やシリコンキャパシター（SiCap）向け検査装置事業など、新たな事業領域への展開を進めております。また、既存の製造設備や技術資産の有効活用を図りながら、事業領域の拡大と収益構造の改善に向けた取り組みを進めております。こうした状況を踏まえ、当社グループでは、既存の半導体検査装置事業における営業活動の強化、製品競争力の向上及び製造体制の効率化を進めるとともに、従来の後工程検査装置分野に加え、半導体前工程検査装置分野への事業領域の拡大を進めております。

半導体前工程検査装置事業につきましては、大阪事業所における既存クリーンルームの活用及び製造・評価体制の整備を進めており、2026年７月から８月にかけて、当社製の前工程検査装置を海外の顧客協力企業へ納入し、実際の半導体製造環境を想定した装置評価を進めております。また、2026年10月15日に当社Webサイトにて公表(＊１)いたしましたとおり、海外大手半導体関連企業との間で秘密保持契約（NDA）を締結し、日本国内の半導体製造工場への装置導入に向けた協議を開始しております。

さらに、シリコンキャパシター（SiCap）向けウエハ検査装置事業など、新たな検査装置分野への展開を進めるとともに、既存の技術資産や製造設備を有効活用し、事業領域の拡大と収益機会の創出に取り組んでおります。しかしながら、これらの新規事業については、本格的な収益貢献に至るまでに一定の期間を要することから、当第３四半期連結累計期間においては、既存事業の受注及び売上の低迷を補うには至っておりません。

以上より、当第３四半期連結累計期間の売上高は238,970千円にとどまり、営業損失591,122千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を612,997千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

＊１　2026年10月15日当社Webサイトにて公表　「半導体前工程検査装置事業の進捗に関するお知らせ」

事業施策

１．アジア、中東地域での受注販売活動の促進

世界半導体市場は、生成AI及びデータセンター向けの先端ロジック半導体や高帯域メモリ（HBM）関連の設備投資を中心に成長が続いておりますが、当社グループが主力とするディスプレイ・ドライバーIC（DDIC）及び汎用ロジックIC等の民生・産業向け半導体分野においては、依然として顧客の新規設備投資に慎重な姿勢が見られ、受注環境は厳しい状況が続いております。特に、当社グループの主要市場である中国及び台湾においては、顧客の設備稼働率に改善の兆しが見られるものの、新規検査装置への設備投資は限定的な状況にあります。一方、中国市場は半導体製造設備の集積が進む重要な市場であり、中長期的には半導体製造能力の拡充や設備更新に伴う検査装置需要が見込まれることから、当社グループでは引き続き同市場を重要な営業基盤と位置付け、受注機会の獲得に向けた活動を強化してまいります。具体的には、当社の100%出資子会社である偉恩測試技術（武漢）有限公司（以下「ウインテスト武漢」という。）を中国市場における製造・販売拠点として活用し、日本国内の開発・営業部門との連携を一層強化することで、顧客ニーズの把握から装置提案、技術評価、製造、納入及びアフターサポートまでの一貫した対応体制の充実を図ってまいります。

また、営業部門と技術サポート部門との情報共有を促進し、既存顧客に対する装置更新提案や新規顧客への販売活動を強化するとともに、顧客の製造工程における検査課題に対応した装置仕様の提案及び技術的な支援を進めてまいります。さらに、ウインテスト武漢における最終組立工程の品質向上、製造工程の効率化及び顧客対応力の強

化を図り、製造コストの適正化と収益性の改善に取り組んでまいります。

既存の半導体検査装置事業につきましては、次世代高精度高速検査システム「WTS-577SX」、及び多チャンネル対応の「WTS-9000」普及型の「WTS-577SR」を主軸として、中国・台湾市場を中心に国内外の顧客への提案活動を継続しております。また、現在開発専用機として開発した「WTS-588D」を量産機へと展開させた「WTS-588」の開発を行っており、本年度末を待たずリリースできる見込みです。本装置に関しましては完成リリースに際し詳細をお知らせいたします。これらの装置について、顧客による技術評価や導入検討への対応を進めるとともに、製品性能及び検査機能の拡充を図り、設備投資需要の回復局面における受注獲得につなげてまいります。

一方、当社グループでは、従来の民生・産業向け半導体検査装置市場への依存度を低減し、収益機会の拡大を図るため、半導体前工程検査装置分野への事業展開を進めております。2025年12月に新規参入を公表した同事業につきましては、大阪事業所における製造・評価環境の整備及び製造技術の習得を進め、2026年７月から８月にかけて海外の顧客協力企業への装置納入及び実機評価を開始しております。さらに、2026年10月には海外大手半導体関連企業との秘密保持契約（NDA）締結及び国内半導体製造工場への装置導入に向けた案件協議の開始を当社Webサイトにて公表(＊１）するなど、国内外における新規顧客の開拓を進めております。また、シリコンキャパシター（SiCap）向けウエハ検査装置事業への展開を通じて、従来の検査装置市場に加え、AI関連及び先端半導体分野における新たな事業機会の獲得を目指しております。

当社グループは、これらの事業施策を通じて、既存検査装置の受注回復と新規事業領域における収益機会の拡大を図るとともに、製造・販売体制の効率化及び収益性の改善を進め、継続的な営業損失の縮小と経営基盤の安定化に取り組んでまいります。

＊１　2026年10月15日当社Webサイトにて公表　「半導体前工程検査装置事業の進捗に関するお知らせ」

２．技術開発の強化

当社グループは、既存の半導体検査装置事業における製品競争力の向上と、新たな半導体検査市場への事業領域の拡大を重要な経営課題と位置付け、これまで培ってきた高速デジタル信号処理技術、高精度測定技術及び多チャンネル並列検査技術を基盤として、次世代検査装置の研究開発を進めております。

先端ロジック半導体検査装置につきましては、I/O 1,024チャンネルへの拡張及びデジタル信号速度1.6Gbpsへの対応を目指した機能開発を進めるとともに、次世代LCDデータキャプチャーボードの開発及び既存検査装置への機能拡張に取り組んでおります。また、次世代の高速検査技術として、最大4.0Gbpsのデジタルパターン信号生成を目標とする高速リソース「USDR」の開発を継続し、より高度な半導体デバイスの検査要求への対応を図っております。さらに、国内の半導体関連顧客からの要求に対応するため、高速・高電圧ロジック検査機能を備えた次世代オプションの開発を進めております。これらの技術開発を通じて、従来のディスプレイ・ドライバーIC及び汎用ロジックIC向け検査装置に加え、より広範なロジック半導体デバイスへの対応を図り、製品競争力の向上と新たな受注機会の獲得を目指してまいります。

新たな事業領域である半導体前工程検査装置につきましては、大阪事業所における製造・評価体制の整備を進めるとともに、装置の組立・調整技術、測定精度の確保及び品質管理技術の習得を推進しております。また、海外の顧客協力企業における実機評価を通じて、装置性能及び顧客要求への適合性を確認し、今後の製造・販売体制の確立に向けた技術的な基盤の強化を進めております。加えて、シリコンキャパシター（SiCap）向けウエハ検査装置「WTS-513SC」につきましては、開発を完了し、2026年12月からの販売開始を予定しております。本装置は、シリコンウエハ上に形成されたキャパシターの電気特性を検査するものであり、当社が有する高精度測定技術及び多チャンネル検査技術を応用した製品です。今後、AI関連機器や高性能コンピューティング（HPC）分野等で使用される高性能電子部品の検査需要への対応を図り、新たな検査装置市場への展開を進めてまいります。

パワー半導体向け検査装置につきましては、電気自動車（EV）関連市場における設備投資の調整等により、足元の市場環境には不透明感が見られるものの、省エネルギー化や電力制御の高度化に伴い、中長期的な需要が期待される分野と認識しております。当社グループでは、既存の検査技術を活用しながら、顧客ニーズ及び市場動向を踏まえた検査装置の設計・開発を引続き継続してまいります。

また、国内の汎用デジタル半導体検査市場への対応に加え、半導体デバイスを実際の使用環境に近い状態で評価するSLT（システムレベルテスト）分野についても、顧客との技術的な連携を通じて、検査方式及び装置構成の検討を進めております。

当社グループは、これらの研究開発活動を通じて、既存検査装置の高機能化と製品ラインアップの拡充を図るとともに、半導体前工程及びAI関連分野を含む新たな市場への技術展開を推進し、将来の受注拡大と収益基盤の強化に取り組んでまいります。

３．隣接領域の展開と製品化

当社グループは、従来の半導体検査装置事業に加え、これまで培ってきた精密測定技術、制御技術、製造技術及び国内外の販売ネットワークを活用し、ヘルスケア、産業機器、環境関連機器及び工場自動化等の隣接領域への

事業展開を進めております。これらの取り組みを通じて、特定の半導体市場の設備投資動向に左右されにくい事業構造への転換を図り、中長期的な収益基盤の多様化を目指しております。

当社が保有する特許技術である自重補償機構（以下「MGC技術」という。）を応用したトラック用テールゲートリフターにつきましては、慶應義塾先端科学技術研究センターとの共同開発を進めております。2025年10月に富士スピードウェイで開催された「ジャパントラックショー in Fujispeedway 2025」において実機展示及び体験型デモンストレーションを実施，その後、2026年５月にパシフィコ横浜で開催された「ジャパントラックショー2026」など複数の展示会に参加し、有力架装関連企業との協業に向けた接点を得ております。本装置は、モーターや油圧機構に依存せず、荷役作業時の操作負担の軽減を図るものであり、物流分野における省力化及び作業効率の向上に寄与することを目指しております。今後は、架装関連企業等との連携を通じて製品の実用化及び販売体制の構築を進めるとともに、昇降機能付き台車等への応用展開を検討してまいります。

株式会社TAOS研究所と連携して開発を進めておりますIoTヘルスケア装置「Body Beat」につきましては、心電図（ECG）及び心弾動図（BCG）等の生体信号を活用したバイタル情報の測定・解析技術を応用し、日常生活の中で健康状態の変化を把握するヘルスケア管理システムの量産化を進めております。現在、PVC加工メーカーとの連携などを通じて量産体制を構築中です。またスマートフォン向けアプリケーションの開発を完了しリリースを行いました。引続き機能改善を継続するとともに、製品品質の向上と量産・ECサイトを通じた販売体制の整備を進めております。今後は、多角的に事業会社や販売代理店等を通じた市場展開を目指してまいります。

環境関連事業として取り組んでおりますアルカリイオン洗浄水生成装置につきましては、2025年６月19日に公表いたしました株式会社レドックステクノロジーとの開発協業を通じて、高性能電解槽を採用した装置の開発完了から製造に歩を進めております。従来の化学薬品を使用する洗浄工程の代替手段として、半導体関連工場や機械加工分野等における洗浄用途への展開を目指し、生成能力及び洗浄性能の向上に取り組んでおります。今後は、製品の性能評価及び製造体制の整備を進め、産業用途における顧客開拓と事業化を推進してまいります。また、当社は当アルカリイオン洗浄水生成装置の純水生成システム部分を切り離し、業務用（ビル、工場等）エアコン室外機の冷却、効率アップを行う、Pure-Kalisの販売を開始しており、大手製造業（中部地方 （東海地方））様との供給基本契約を締結、積極的に事業を進めております。

2025年７月に正式販売を開始した液体レンズ「RYUGU」につきましては、電圧制御により焦点位置を高速に変化させることができる特長を活かし、大学・研究機関向けを中心に販売活動を進めております。また、産業用途への展開として、製造ラインの監視カメラや各種画像センシング機器等への応用を進め、顧客ニーズに応じた製品提案及び用途開拓を継続しております。今後は、研究開発用途に加え、一部受注を頂いている産業機器分野、光学機器メーカなどにおける販売機会の拡大を図ってまいります。

マイクロCT・X線三次元断層撮影検査装置「WTS-CT130」につきましては、横浜本社に設置したデモ機を活用し、顧客から持ち込まれた試料の撮影・評価を通じて、装置性能の紹介及び導入検討への技術支援を進めております。また、国内販売代理店との連携を通じて、研究開発、電子部品及び精密機器等の検査用途に向けた営業活動を継続し、販売機会の拡大を目指してまいります。また、新たに受託撮像ビジネスを開始し、当社WEBページで受付を行なっております。

さらに、工場自動化分野への展開として、自律走行搬送ロボット（AMR）の販売事業を進めております。半導体・電子部品製造工場等における搬送作業の自動化、省人化及び生産効率の向上に対する需要を背景に、既存の顧客ネットワークを活用した営業活動及び販売体制の構築を進めております。今後は、顧客の製造現場における搬送ニーズに対応した製品提案を行い、新たな収益機会の獲得を目指してまいります。

また、AIデータセンター関連分野においては、サーバー設備の稼働状況、温度、電力使用状況等を監視するシステムの開発及び事業化に向けた取り組みを進めております。AI関連インフラの拡大に伴い、設備の安定稼働及び運用効率の向上に対する需要が見込まれることから、当社が一部出資をしております関係企業との連携を通じて技術開発及び事業機会の創出を図ってまいります。

これらの新規事業につきましては、製品化及び事業化の進捗段階がそれぞれ異なり、現時点における連結業績への寄与は限定的でありますが、既存の技術資産及び製造・販売基盤を有効活用するとともに、外部企業との協業を通じて開発・事業化に伴う負担の適正化を図り、早期の収益化に向けた取り組みを進めてまいります。

当社グループは、これらの隣接領域における事業展開を通じて、半導体検査装置事業への依存度を段階的に低減し、収益源の多様化及び経営基盤の安定化を目指してまいります。

財務施策

財務面につきましては、事業領域の拡大及び財務基盤の強化を目的として、2025年12月26日開催の取締役会において、GFA株式会社（現：abc株式会社）を割当先とする第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付、潜在株式数7,000千株）の発行を決議いたしました。2026年１月13日には本新株予約権の発行に係る払込が完了し、同年10月20日をもってすべての権利行使が完了したことにより、新株予約権の発行に係る払込を含め、合計約５億８千万円の資金を調達しております。なお、事業の進捗状況及び資金需要等を踏まえ、調達資金の一部使途

及び支出予定時期について見直しを行い別途公表(＊２）しております。また、当面の運転資金を確保するため、2026年11月16日付でReDigital株式会社との間で金銭消費貸借契約を締結し、50,000千円の借入を実行いたしました。あわせて、同日開催の取締役会において、当該借入を含め総額200,000千円を上限とする資金の借入を行うことを決議しております。残額150,000千円については、現時点において契約の締結には至っておらず、今後、資金需要に応じて協議を進めてまいります。詳細は「(重要な後発事象の注記)」に記載のとおりであります。今後につきましては、既存の半導体検査装置事業における受注回復及び収益力の改善を図るとともに、半導体前工程検査装置事業や新規事業の展開に必要な資金を確保するため、事業の進捗及び資金需要に応じた機動的な資金調達を検討してまいります。具体的には、金融機関等からの借入、資本市場を通じた資金調達及び事業会社との資本・業務提携等、複数の調達手段を検討し、財務基盤の安定化と事業成長に必要な資金の確保に取り組んでまいります。

また、半導体検査関連機器メーカーやパワー半導体関連企業等との事業提携及びM&Aについても、事業上の相乗効果、収益性並びに財務負担を十分に勘案しながら検討を進め、半導体前工程検査市場への展開、対応可能な検査領域の拡充及び非半導体分野における収益基盤の強化を図ってまいります。これらの施策を推進するにあたっては、資金繰りの安定化を優先し、事業の進捗状況及び投資効果を慎重に見極めながら、経営資源の効率的な配分、設備投資の優先順位の見直し及び費用管理の徹底を図り、営業キャッシュ・フローの改善と財務体質の強化に取り組んでまいります。

しかしながら、上記の事業施策及び財務施策については、半導体市場の需要動向、顧客の設備投資状況、新規事業の収益化の進捗並びに今後の資金調達の実現可能性等、外部環境を含む不確定要素が存在しております。このため、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるものと判断しております。

＊２　2026年11月６日公表　「第13 回新株予約権による調達資金の額、資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

当社は、当第３四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ242,700千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,272,358千円、資本剰余金が2,558,844千円となっております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2025年１月１日 至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2026年１月１日 至　2026年９月30日）
減価償却費	8,595	1,315

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象の注記）

(1) 新株予約権の行使による増資

2026年10月１日から2026年10月20日までに第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の全部行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

（ⅰ）行使された新株予約権の個数　：13,629個

（ⅱ）増加した株式の種類及び株式　：普通株式　1,362,900株

（ⅲ）資本金の増加額：49,561千円

（ⅳ）資本準備金の増加額：49,561千円

以上より、2026年11月14日現在の発行済株式総数は60,641,000株、資本金は2,321,920千円、資本準備金は2,321,920千円となっております。

(2) 資金使途の変更

当社は、2026年11月６日開催の取締役会において、第13回新株予約権による資金使途及び支出予定時期を変更する決議をいたしました。

（ⅰ）変更の理由

本新株予約権については、発行後の株価推移に伴い、総調達額が当初の想定を下回る結果となりました。この結果、最終的な調達額は、584,523千円（差引手取額:576,102千円）となり、当初の払込費用の総額733,100千円（差引手取概算額：724,747千円）に対して、約２割程度減少することとなりました。

当社では、事業の立上げに必要な機能及び品質を確保しながら、限られた資金をより効率的に活用するため、当初の設備投資計画及び資金配分について見直しを進めることとし、当社が既に保有するクリーンルーム設備及び関連設備を可能な限り再利用するとともに、新規設備の導入範囲や工事内容を最適化することで、初期設備投資額の削減を図り、調達資金の減少に対応する方針といたしました。

（ⅱ）変更の内容（又は変更前後の状況）

（変更前）2026年６月25日公表「資金使途支出予定時期の変更に関するお知らせ」

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
①新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用	256,000	2026年１月～2027年３月
②専門技術者、サポート要員の採用と教育、育成	50,000	2026年１月～2026年12月
③開発中の新規３事業関連プロモーション費用及び量産に関わる費用	50,000	2026年１月～2026年12月
④その他運転資金	368,747	2026年１月～2026年12月
計	724,747	

（変更後）2026年11月６日公表「第13回新株予約権による資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
①新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用	120,248	2026年１月～2027年３月
②専門技術者、サポート要員の採用と教育、育成	29,391	2026年１月～2027年１月
③開発中の新規３事業関連プロモーション費用及び量産に関わる費用	42,834	2026年１月～2026年12月
④その他運転資金	379,628	2026年１月～2026年11月
⑤(新規)上記①、クリーンルームへの追加拡張工事	4,000	2026年11月～2026年12月
計(差引手取額)	576,102	

※　差引手取額は、584,522千円から発行諸費用の額8,420千円を差し引いた576,102千円となります。

（ⅲ）今後の見通し（業績への影響）

本件による2026年12月期の連結業績への影響は軽微であります。なお、半導体前工程検査装置事業につきましては、2027年３月以降の本格的な事業展開を予定しており、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

(3) 資金の借入

当社は、2026年11月16日開催の取締役会において、総額200,000千円を上限とする資金の借入を行うことを決議いたしました。このうち50,000千円について、同日付で金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行いたしました。

１．取締役会決議の内容

（ⅰ）借入限度額　　：200,000千円（後述２の借入を含む）

（ⅱ）資金使途　　：運転資金

２．実行した借入の内容
（ⅰ）借入先　　：ReDigital株式会社
（ⅱ）借入金額　　：50,000千円
（ⅲ）契約締結日及び借入実行日：2026年11月16日
（ⅳ）返済期限　　：2027年１月29日
（ⅴ）利率　　：年15.0％
（ⅵ）担保及び保証　：無担保・無保証
（ⅶ）資金使途　　：運転資金

なお、残額150,000千円については、現時点において契約の締結には至っておらず、借入の時期及び条件等は未定であります。